

低共熔點金/錫焊料

特點

- AuSn (金/錫) 合金的焊點強度很高
- 與標準的焊料相比, AuSn 合金的抗腐蝕性極好, 熱導很高
- AuSn 合金與貴金屬兼容

何時使用 AuSn 低共熔點焊料

- **貼片:** 由於要求溫度高, 往往要用熔點高的貼片焊料。低共熔點 AuSn 的熔點是 280°C, 符合這些要求。
- **高可靠性應用:** AuSn 與使用金的金屬化表面兼容, 加上它的長期可靠性, 是微波系統、醫療和空間等要求高可靠性應用的首選。
- **密封:** AuSn 的潤濕性很好, 它的熔點相對較低 (與某些用於貼裸片的合金相比), 它的長期可靠性高, 適合用於密封。
- **代替銅焊:** 低共熔點 AuSn 的抗張強度是 275 MPa (40,000 磅/平方英寸), 在焊接的溫度下需要保持很高的強度時, 它是代替銅焊的一個辦法。

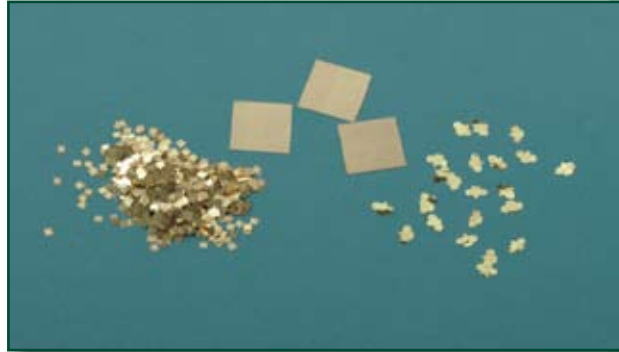
AuSn 的各種產品

錫泰公司的低共熔點 AuSn 焊料有許多種, 其中有:

- 焊錫絲
- 焊錫帶
- 成型焊料
- 焊膏

精密的焊錫絲、焊錫帶或者成形焊料的尺寸準確, 滿足客戶的要求。

焊錫膏有各種參數的產品, 滿足各種不同的需要。



物理特性

成份	Au80Sn20
熔點	280°C/536°F
密度	14.51 grams/cm ³
抗張強度	40,000 psi
抗剪強度	40,000 psi
熱膨脹係數	16ppm/°C (在20°C時)
熱導	0.57 w/cm°C (在20°C時)
楊氏模量	8.57 x 10 ⁶ psi

所有信息仅供参考。不能用作产品的规范。

提供 AuGe、AuSi 和純 Au 的成形焊料。

技術支援

錫泰公司的工程師具備豐富的國際經驗, 為客戶提供高水平的技術支援。我們的技術支援工程師在材料科學及其在電子和半導體的應用的各个方面都有豐富的知識, 在焊料特性、合金兼容性, 以及成型焊料、焊錫絲、焊錫帶、焊錫膏的選擇方面, 為客戶提供專業性的建議。錫泰公司的技術支援工程師會迅速地回答所有的技術問題。

材料安全資料

關於本產品的材料安全資料 (MSDS), 請上網查閱, 網址: <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>。

此產品說明書只提供一般性資訊。不能保證或擔保這些資訊所述產品的性能, 也不可以把這些資訊看作是對所述產品的保證

或擔保。售出的產品只承諾隨產品包裝及發票所附的書面保證及有關的限制條件。

表格編號 98366(TC A4) RO

www.indium.com

china@indium.com

亞洲: 新加坡: +65 6268 8678

中國: 蘇州、深圳、柳州: +86 (0)512 628 34900

歐洲: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400

美國: Utica, Clinton, Chicago: +1 315 853 4900



經
ISO 9001
注册